

◎ 新技術・新製品のご紹介 ◎

新技術

はんだの低サイクル疲労試験技術

① 概要

電子機器用の低融点鉛フリーはんだの高温低サイクル疲労試験技術を確立しました。

② 主な仕様

試験環境 : -40~+125℃、大気中

ひずみ範囲 : ±1.5%以内

制御波形 : 三角波、ノコギリ波、台形波

荷重 : 10kN (油圧サーボ型軸力疲労試験機)

③ 特徴

はんだ材は非常に軟質なため、ひずみ検出用の伸び計の押当て力により座屈する。当社では、押付け力調節およびバランス機構を開発し、融点比0.9の高温下でも、はんだの低サイクル疲労試験ができる試験技術を確立。

④ 利用分野

はんだをはじめとした軟質材料の低サイクル疲労試験

